

Title (en)
Liquid cooled plate mould

Title (de)
Flüssigkeitsgekühlte Plattenkokille

Title (fr)
Lingotière à plaques refroidi par liquide

Publication
EP 1138417 A1 20011004 (DE)

Application
EP 01107099 A 20010322

Priority
• DE 10015037 A 20000325
• DE 10039625 A 20000809

Abstract (en)
Liquid-cooled plate mold comprises high heat conducting mold plates (1) made from copper or copper alloy connected to a water chamber and/or support plate (4) using fixing elements (2). Molded parts (6) having a thread (5) are arranged on the water side of each mold plate and are connected to the mold plates as fixing pieces by solder connections (7, 7') or by welding connections. Preferred Features: The molded parts and/or the fixing pieces are made from a conducting material, such as CuAg, CuCrZr, CuNiBe or CuNiFe. The fixing pieces are connected to the mold plates by a soft solder layer.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine flüssigkeitsgekühlte Plattenkokille zum Stranggießen von Metallen insbesondere von Stahlwerkstoffen, umfassend hochwärmeleitfähige Kokillenplatten 1 aus Kupfer oder Kupferlegierungen, die mittels Befestigungsbolzen 2 jeweils mit einem Wasserkasten bzw. mit einer Stützplatte 4 verbunden sind. Auf der Wasserseite jeder Kokillenplatte 1 sind mit Gewinde 5 ausgebildete Formteile 6 angeordnet, die durch Lötverbindungen 7, 7' oder durch Elektronenstrahlschweißung 12 mit den Kokillenplatten 1 kraftschlüssig als Befestigungsstücke verbunden sind. <IMAGE>

IPC 1-7
B22D 11/04

IPC 8 full level
B22D 11/04 (2006.01); **B22D 11/055** (2006.01); **B22D 11/057** (2006.01); **B22D 11/059** (2006.01); **B23K 35/26** (2006.01); **B23K 35/28** (2006.01); **B23K 35/30** (2006.01)

CPC (source: EP US)
B22D 11/055 (2013.01 - EP US); **B22D 11/059** (2013.01 - EP US)

Citation (search report)
• [X] DE 2154101 A1 19720504
• [DX] DE 19716450 A1 19980528 - KM EUROPA METAL AG [DE]
• [A] DE 19835111 A1 20000210 - SCHLOEMANN SIEMAG AG [DE]
• [X] PATENT ABSTRACTS OF JAPAN vol. 009, no. 107 (M - 378) 11 May 1985 (1985-05-11)

Cited by
ITMI20120153A1; EP1398099A1; EP1555073A1

Designated contracting state (EPC)
AT DE ES IT NL

DOCDB simple family (publication)
EP 1138417 A1 20011004; BR 0101148 A 20011030; CA 2341920 A1 20010925; CN 1322596 A 20011121; JP 2001314942 A 20011113; MX PA01002885 A 20030820; US 2001042608 A1 20011122

DOCDB simple family (application)
EP 01107099 A 20010322; BR 0101148 A 20010323; CA 2341920 A 20010323; CN 01111912 A 20010323; JP 2001084758 A 20010323; MX PA01002885 A 20010320; US 81529201 A 20010322